

mini PFE 100 / 200

Célula limpia física de precisión



Equipo capaz de procesamiento automático continuo de las superficies superior e inferior de piezas de trabajo en forma de tira

La celda pequeña que usa pistola ancha se usa para la industria eléctrica, como placas de circuito impreso o semiconductores. Al procesar ambos lados de manera uniforme, se puede aplicar para forma de barra y forma de hoja. Aplicable para placa de cerámica y Cu.

Característica

- Las funciones están integradas, pero su calidad de procesamiento de chorreado en húmedo sigue siendo la misma. Célula recientemente desarrollada como un propósito de tamaño pequeño y ahorro de costos.
- Las piezas compactas de chorreado y enjuague con agua facilitan el mantenimiento de los actuadores; simplemente abriendo una cubierta del transportador. También el cañón ancho y la bomba como partes principales, aún conservan la alta durabilidad original.
- Línea de 2 tipos (mini PFE 100/200) según el tamaño de la pieza.

Especificaciones

mini PFE 100

Tamaño	1200 (ancho) × 1250 (profundidad) × 1600 (alto) mm
tamaño de trabajo	Ancho: 20-100 mm Longitud: 100-250 mm Espesor: 0,1-1,5 mm
Velocidad de transporte del transportador	0.1~3.0m/min
Pistola	Pistola ancha de 110 mm Una para cada parte superior e inferior
Fuente de alimentación	AC200V, 50/60Hz, 3 fases
El consumo de energía	Aproximadamente 2,6kW (Potencia aparente nominal total de todos los equipos)
Presión de suministro de aire	0.5MPa-0.7MPa
Consumo de aire	4,1 m ³ /min (NTP a 0,25 MPa de presión de aire de chorro preestablecida)

mini PFE 200

Tamaño	1200 (ancho) × 1650 (profundidad) × 1650 (alto) mm
tamaño de trabajo	Ancho: 20-200 mm Longitud: 100-250 mm Espesor: 0,1-1,5 mm
Velocidad de transporte del transportador	0.1~3.0m/min

Pistola

Fuente de alimentación

El consumo de energía

Presión de suministro de aire

Consumo de aire

Pistola ancha de 220 mm Una para cada parte superior e inferior

AC200V, 50/60Hz, 3 fases

Aproximadamente 4,3kW (Potencia aparente nominal total de todos los equipos)

0.5MPa-0.7MPa

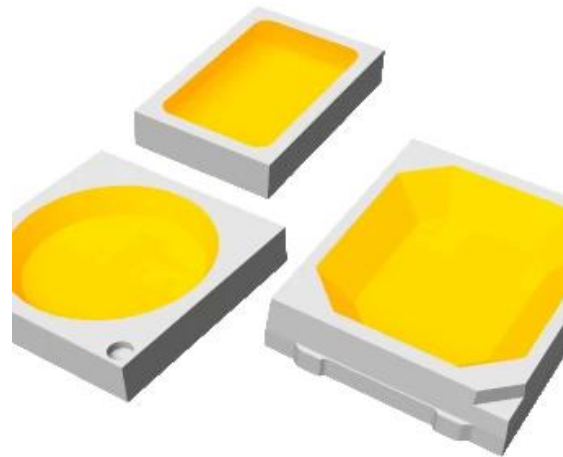
7,7 m³/min (NTP a 0,25 MPa de presión de aire de chorro preestablecida)

Páginas relacionadas

Aplicaciones relacionadas



[Pretratamiento para enchapado para eliminar rebabas sin dañar los semiconductores \(desbarbado\)](#)



[Método de eliminación de resina sobremoldeada que reduce drásticamente el daño a los chips LED enterrados](#)



[Método de procesamiento para eliminar rebabas finas \(rebabas flash\) sin dañar el paquete LED](#)